



Anfragen zum Plenum zur Plenarsitzung am 24.06.2025 – Auszug aus Drucksache 19/7276 –

Frage Nummer 49 mit der dazu eingegangenen Antwort der Staatsregierung

Abgeordneter
**Oskar
Lipp**
(AfD)

Ich frage die Staatsregierung, wie viel Geld hat die Staatsregierung seit der Ankündigung der Bayerischen Halbleiterinitiative im Oktober 2021 insgesamt sowie jeweils in den Jahren 2021, 2022, 2023 und 2024 für Maßnahmen im Rahmen dieser Initiative – insbesondere für Chipdesign, Forschung, Förderung von Unternehmen, Infrastruktur und Ansiedlungen – aufgewendet, zahlte der Freistaat im Rahmen der Kofinanzierung von IPCEI- oder EU-Chips-Act-Projekten seit einschließlich dem Jahr 2021 bis einschließlich dem Jahr 2024 mehr Landesmittel ein, als er durch Fördermittel des Bundes und der EU zurückerhielt (bitte Brutto-Netto-Verhältnis insgesamt sowie für die Jahre 2021, 2022, 2023 und 2024 aufschlüsseln) und wie viele neue Produktionsstätten für Halbleiterbauelemente (Fertigungsstätten) und neue Entwicklungs- bzw. Designlabors für Mikroelektronik und Chipdesign wurden seit der Ankündigung der Bayerischen Halbleiterinitiative im Oktober 2021 in Bayern neu geschaffen (falls möglich, bitte diese Vorhaben jeweils quantitativ und qualitativ beschreiben)?

Antwort des Staatsministeriums für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie

Zu dem ersten Teil der Frage wird mitgeteilt:

- a) Förderung von forschungsnaher Infrastruktur
- Bayerisches Chip Design Center (BCDC):
50 Mio. Euro (Förderbescheid am 20. November 2023)
 - Beteiligung Bayerns an den beiden Pilotlinien APECS und WBG im Rahmen des EU-Chips-Act durch die bayerischen Fraunhofer-Institute IIS, EMFT, AISEC, und IISB:

Kofinanzierung der beiden Pilotlinien durch das Bayerische Wirtschaftsministerium mit über 13,3 Mio. Euro ist Voraussetzung dafür, dass über 66 Mio. Euro Bundes- und EU-Gelder nach Bayern fließen können. (Übergabe Förderbescheid am 20. März 2025)

- FuE-Initiative Trusted Electronics der Fraunhofer Institute AISEC, IIS, EMFT:

Förderung: 29,3 Mio. Euro zusätzlich 5,7 Mio. Euro für Geräteinvestitionen im Rahmen des EU-REACT-Programms

b) Fördermaßnahmen

- Important Project of Common European Interest (IPCEI) Mikroelektronik und Kommunikationstechnologien: Durch die Aufteilung der Fördermittel zu 70 Prozent auf den Bund und 30 Prozent auf das Land über den Förderzeitraum entsteht eine erhebliche Hebelwirkung, um Bundesförderung nach Bayern zu lenken. Die geltenden Verwaltungsvereinbarungen zwischen Bund und Bayern gehen für Unternehmensprojekte an Standorten in Bayern mit einem Gesamtprojektvolumen von ca. 2 Mrd. Euro von einer Gesamtförderung von ca. 890 Mio. Euro aus, von denen der Freistaat anteilig knapp 270 Mio. Euro trägt. Bayern hat bisher Landesmittel in Höhe von ca. 37 Mio. Euro ausgezahlt.
- Förderaufruf „Elektronische Systeme und Prozesstechnologien“ im Rahmen der Förderlinie Digitalisierung des Bayerischen Verbundforschungsprogramms (BayVFP): Seit 2021 wurden Verbundforschungsvorhaben mit unmittelbarem Bezug zu Halbleitertechnologien mit einem Fördervolumen von 19,1 Mio. Euro bewilligt (2021: 4,9 Mio. Euro, 2022: 0,8 Mio. Euro, 2023: 8,9 Mio. Euro, 2024: 4,5 Mio. Euro).
- Bundesministerium für Wirtschaft und Energie „Bekanntmachung für die Förderung von innovativen Investitionsprojekten im Rahmen des Europäischen Chip-Gesetzes“: Das Verfahren läuft, mehrere bayerische Unternehmen sind beteiligt. Mit ersten Förderbescheiden wird im 2. Halbjahr 2025 gerechnet.

Zu der Frage nach neuen Produktionsstätten und neuen Entwicklungs- bzw. Designlabors liegen dem StMWi keine Statistiken vor.